

2022年4月26日

**SORD、REC が共同開発中のマルチセンシングモジュール・プラットフォーム  
「MSM-PF」が東京ビッグサイトで行われる「第6回 AI・人工知能 EXPO【春】」に出展  
～誰もが低コストで短期間開発が可能な使いやすい IoT センサプラットフォーム～**

株式会社ソード

株式会社ソード(注1 以下 SORD)と株式会社レスターエレクトロニクス(注2 以下 REC)は「マルチセンシングモジュール・プラットフォーム(以下 MSM-PF)」を、2022年5月11日(水)から13日(金)までの3日間東京ビッグサイト(東京国際展示場)で開催される NexTech Week2022【春】「第6回 AI・人工知能 EXPO【春】」に出展します。

今回の出展は、REC、株式会社 PALTEK(注3)、株式会社プリバテック(注4)、P C I ホールディングス株式会社(注5)ならびに、そのグループ企業である P C I ソリューションズ株式会社(注6)、SORD を含めた6社による共同出展となります。

展示ブース(南展示棟9-11)では、多種多様なセンサを取付けた金型ダイセット+エアプレス機を設置し、多種、複数のセンサを簡単に同期測定できる MSM-PF の特徴を活かし、プレス工程におけるロードセル、変位センサ、AE センサを同期測定・解析するまでの流れを体験いただきます。

尚、展示ブースへ設置する機器の手配については、MSM-PF の実証試験を行っている精密鍛造金型メーカーの株式会社ニチダイ(注7)および信和産業株式会社(注8)の協力をいただきます。

MSM-PF は、内閣府が実施する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)(注9) 第2期/フィジカル空間デジタルデータ処理基盤」(管理法人:NEDO(注10))において株式会社デバイス&システム・プラットフォーム開発センター(注11)と SORD、REC が共同開発をしています。IoT が普及していない国内の産業・地域などにおいて、IoT 利用者自身がローコードで簡単に IoT システムを構築してデジタル化の価値を検証し、新規ビジネス創出につなげることを目的としたエッジコンピューティングプラットフォームです。

(注1) 所在地：千葉県美浜区、代表取締役社長：須藤 裕二

<https://www.sord.co.jp/>

(注2) 所在地：東京都品川区、代表取締役社長：山口 秀哉

<https://www.restar-ele.com/>

- (注 3) 所在地：神奈川県横浜市、代表取締役社長：福田 光治  
<https://www.paltek.co.jp/index.html>
- (注 4) 所在地：東京都品川区、代表取締役社長：山下 泰弘  
<https://privatech.jp/index.html>
- (注 5) 所在地：東京都港区、代表取締役社長：横山 邦男  
<https://www.pci-h.co.jp/>
- (注 6) 所在地：東京都港区、代表取締役社長：堀部 保弘  
<https://www.pci-sol.com/>
- (注 7) 所在地：京都府京田辺市、代表取締役社長執行役員：伊藤 直紀  
<https://www.nichidai.jp/>
- (注 8) 所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊東 学  
<https://www.sws-kk.co.jp/index.html>
- (注 9) 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)  
<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/index.html>
- (注 10) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)  
<https://www.nedo.go.jp/>
- (注 11) 所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長兼社長：齋藤 昇三  
<https://www.dsp-c.co.jp/>